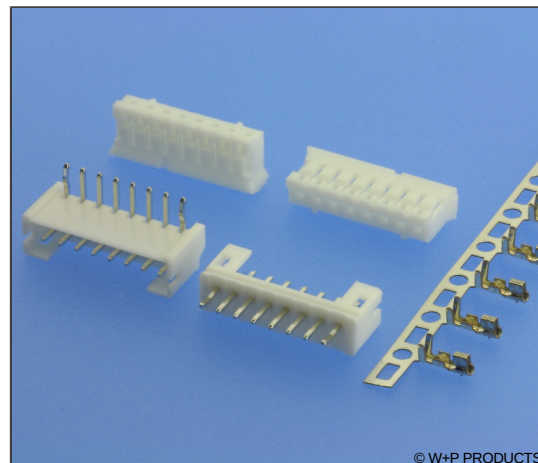


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt

Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

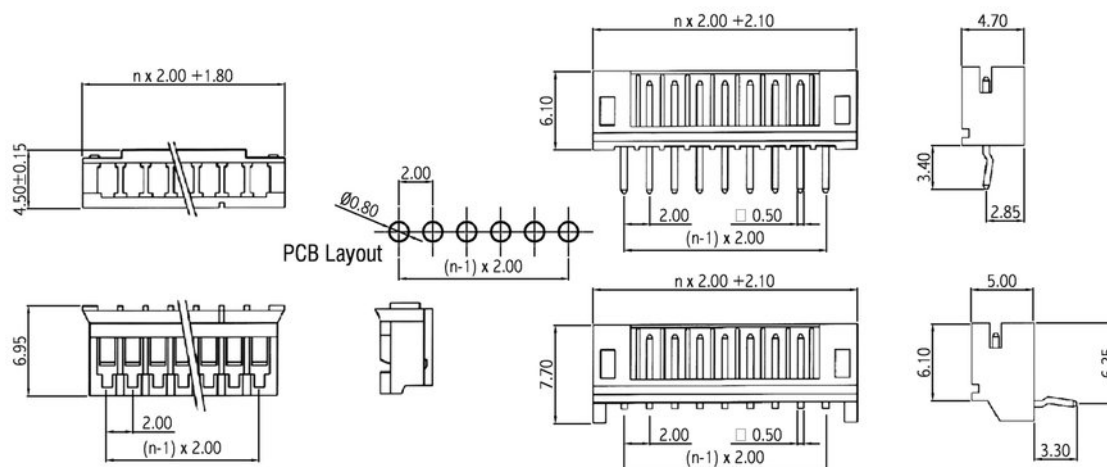
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Applicable Wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	800 V AC
Test Voltage	800 V AC
Nennspannung	100 V AC
Voltage Rating	100 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



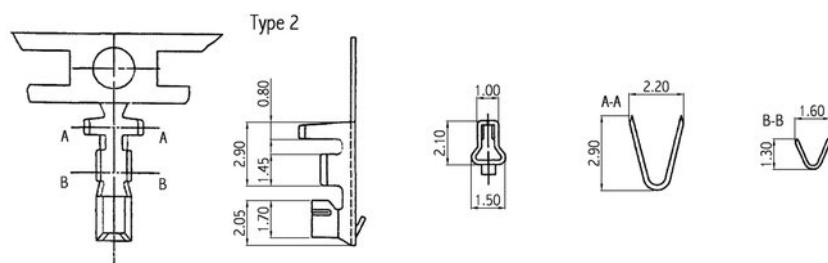
© W+P PRODUCTS

Buchsengehäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:

5210



Series	Contacts*	Type*	Plating
521	12 02-16	3 1 Buchsengehäuse Housing 3 Stiftleiste gerade Straight pin header 4 Stiftleiste gewinkelt Right-angled pin header	50 50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich) Tin plated (not used for housings)



Serie	Contacts	Type	Plating
521	01	2 2 Buchsenkontakte AWG 24-30 Crimp Terminals AWG 24-30	50 50 Verzinnt Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

